

附录XII D 膏药软化点测定法

本法系用于测定膏药在规定条件下受热软化时的温度情况，即指按照下述方法测定，膏药因受热下坠达 25mm 时的温度。用于检测膏药的老嫩程度，并可间接反映膏药的黏性。

仪器装置 如图。A 为试样环，为倒截圆锥形黄铜环，高 6.35mm，上口孔径 17.46±0.5mm，下口孔径 15.88±0.5mm；B 为钢球定位器，内径 20.60mm，使钢球定位于试样中央；C 为钢球，直径为 9.53±0.05mm，质量为 3.50g±0.05g；D 为支架，上支撑板为具有两个水平位置圆环的扁平黄铜板，用于支撑两个试样环，下支撑板为扁平光滑的黄铜板，上支撑板上的倒截圆锥形黄铜环底部与下支撑板上表面距离为 25mm，下支撑板下表面与烧杯底部距离为 16mm±3mm。测定法取供试品，置烘箱中微热软化后，取出，刮下膏料，称取 2 份，各 1.8g，分别填充于两个试样环中，并将试样环上口朝下平放在表面涂有少量甘油并平铺于玻璃板上的铝箔纸上，置 75℃±2℃的恒温箱中加热熔化至表面平整时，取出，室温放置 1 小时，将试样环移至上支撑板圆环内，装上钢球定位器，与钢球分别同置于盛水的烧杯中，在 37℃±1℃的恒温水浴中，平衡 20 分钟后，按图将钢球置于定位器中，自烧杯底部加热，控制每分钟升温 1.0~1.5℃。读取钢球刚触及下支撑板表面时的温度，取平均值作为供试品的软化点。两个测定温度的差值不得过 1.0℃。

删除的内容: 采用软化点测定仪，

删除的内容: (如图 1)

删除的内容: (如图 2)

删除的内容: (如图 3)

删除的内容: (如图 4)

删除的内容: 。

删除的内容: 图 5 为组合装置图。

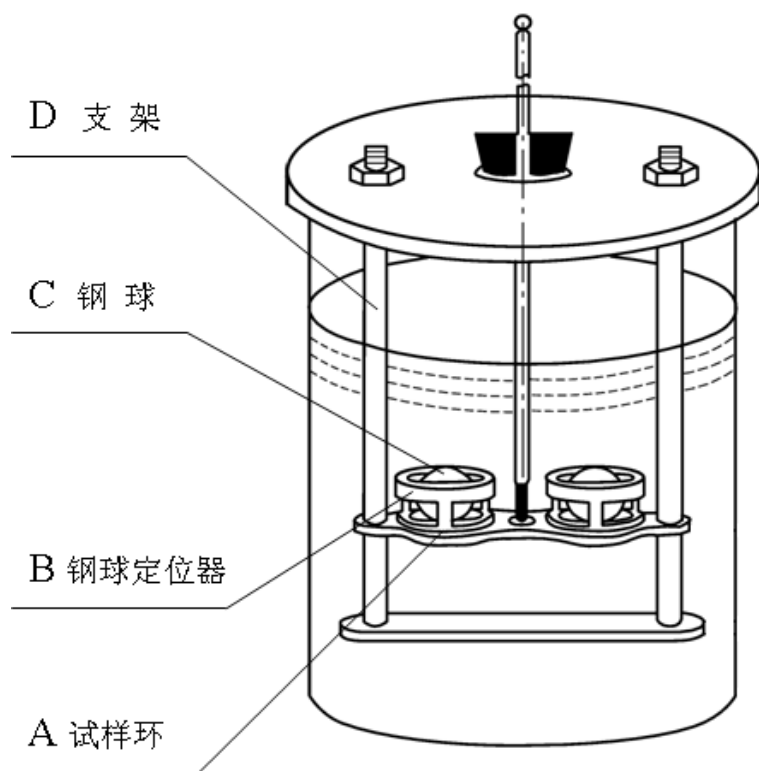
删除的内容: 锡箔

删除的内容: 组合装置

删除的内容: 从

删除的内容: 温度计(经校正)所显示

(图 1、图 2、图 3、图 4 删除，图 5 进行修改)



组合装置图